

At all times water resistant connectors not in use should be covered with a Conec water resistant cap or water tight hood.
Im nicht gesteckten Zustand müssen die wasserdichten Steckverbinder mit einer wasserdichten Conec Kappe oder Haube geschützt werden.

Technical specification:

Technische Daten:

Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz 1 min.
Current rating/ Strombelastbarkeit:	Signal contacts/ 7,5 A (UL) Signalkontakte: 5,0 A (CSA, VDE)
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP67, in mated condition/ IP67, im gesteckten Zustand
Temperature range/ Temperaturbereich:	-25 °C ... +105 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
Shell/ Gehäuse:	Cu alloy, Sn over Ni
Metal bracket/ Metallwinkel:	GD-Zn, Sn over Ni
Frame/ Rahmen:	GD-Zn, Ni
Threaded Insert/ Gewindeeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
O-Ring/ O-Ring:	Silicone, Blue/blau
PCB-Snap/ PCB-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Sealing Compound/ Verguss:	Blue/blau
Hexlocking screw/ Sechskantbolzen:	Stainless Steel/ Edelstahl
Rubber Gasket/ Gummidichtung:	TPE, black/schwarz

Installation specification/

Montagedaten:

Solder parameter for wavesoldering/ Lötparameter im Wellenlötverfahren:	
Solder preheat Temperature/ Vorheiztemperatur:	120 °C for 120 sec. max./ 120 °C für 120 sek. max.:
Solder bath Temperature/ Lötbadtemperatur:	240 °C for 5 sec. max./ 240 °C für 5 sek. max.
Recommended torque Value for thread/ empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	3.1 in.LB / max. 3.5 in.LB/ 35 Ncm / max. 40 Ncm
PCB-Hole Drillings/ recommended Panel cut-out/ Leiterplattenbohrbild/ empfohlener Montageausschnitt:	see Sheet 2/ siehe Seite 2
Panel thickness/ Rückwand Dicke:	1,0 mm min. ... 1,6 mm max.
PCB thickness/ Leiterplatten Dicke:	1,6 mm

(b)

Part no. / Part Marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
6STD15PAU99R40X	3	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel
6STD15PBU99R40X	2	20 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
6STD15PCU99R40X	1	30 µin hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel



dim. in mm

D-SUB Male 15pos. Solder pin angled 90°
with metal bracket, threaded insert, snap and hexlocking screw
D-SUB Stiftleiste 15pol. Lötstift gewinkelt 90°
mit Metallwinkel, Innengewinde, Clip und Sechskantbolzen

drawn/ gez.	Date/Datum	Name
appd./ gepr.	28.10.2016	Unkrüer
	03.11.2016	Lehmenkühler

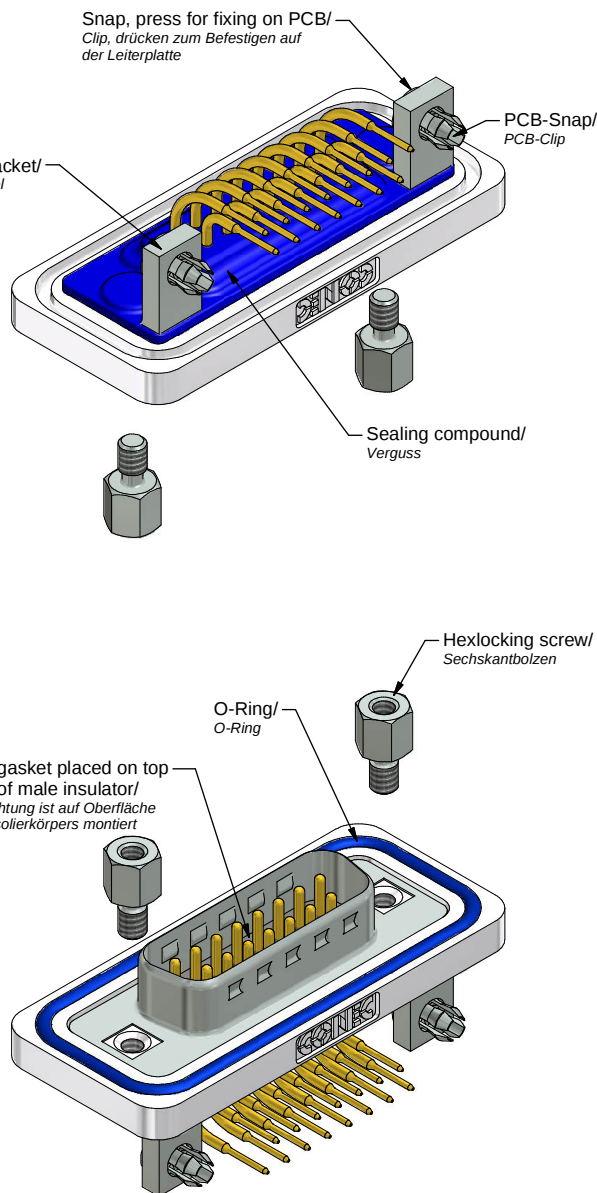
CONEC

dwg no /
Z.-nr.:

15K1A1935

DIN-
A3

1 / 2



Snap, press for fixing on PCB/
Clip, drücken zum Befestigen auf
der Leiterplatte

Metal Bracket/
Metallwinkel

PCB-Snap/
PCB-Clip

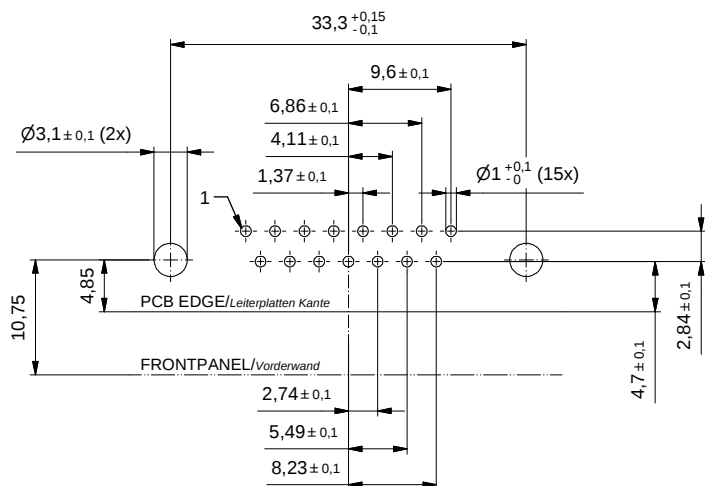
Sealing compound/
Verguss

Hexlocking screw/
Sechskantbolzen

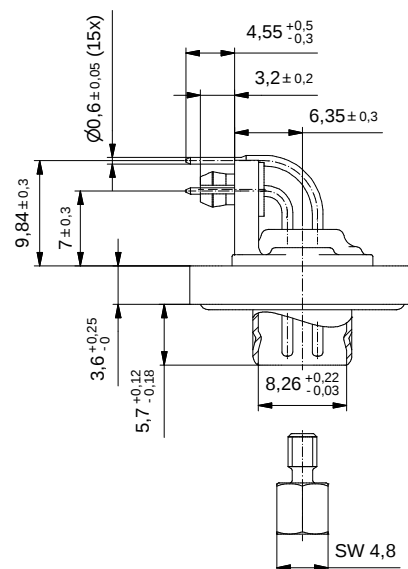
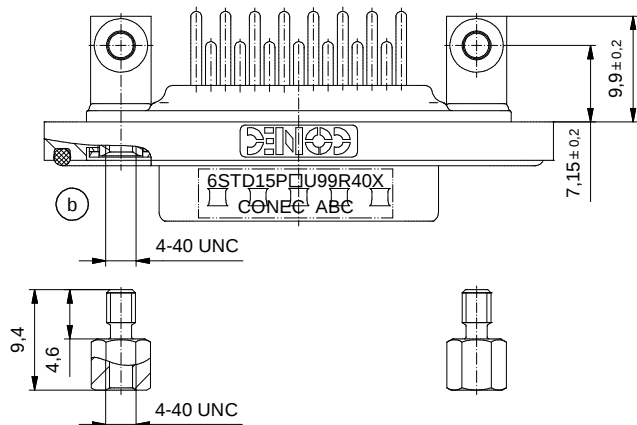
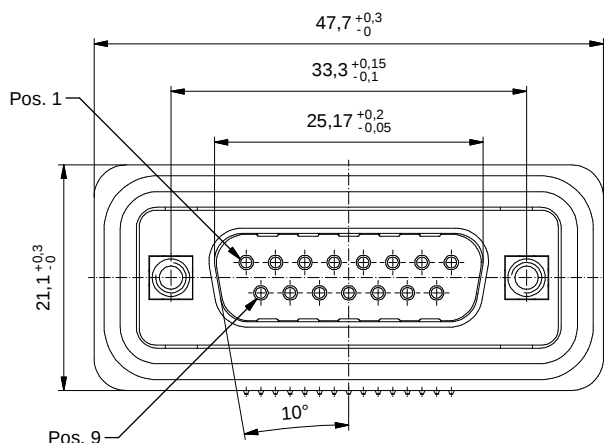
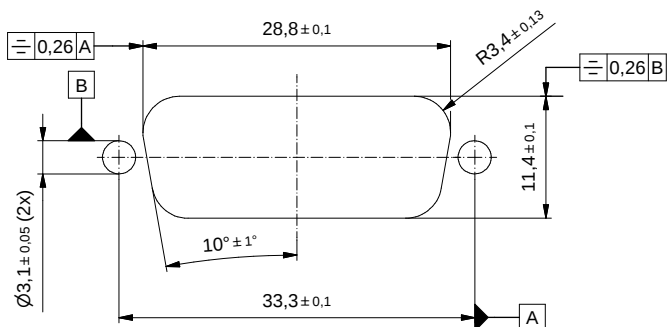
O-Ring/
O-Ring

Rubber gasket placed on top
surface of male insulator/
Gummidichtung ist auf Oberfläche
des Stift-Isolierkörpers montiert

PCB Hole drillings (PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)



Recommended panel cut-out/
empfohlener Montageausschnitt:



		dim. in mm		D-SUB Male 15pos. Solder pin angled 90° with metal bracket, threaded insert, snap and hexlocking screw	
		drawn/gez.	Date/Datum	Name	D-SUB Stiftleiste 15pol. Lötstift gewinkelt 90° mit Metallwinkel, Innengewinde, Clip und Sechskantbolzen
		appd./gepr.	28.10.2016	Unkrüer	
			03.11.2016	Lehmenkühler	
Index: b Ä6395 28.10.16 L.U.	Scale/Maßstab: 2:1				dwg no / Z.-nr.: 15K1A1935
Status: InBearbeitung					DIN-A3
RoHS & REACH compliant/konform					2 / 2